

**Features and Benefits**

- 2.5W/m-K thermal conductivity
- Good compressibility
- RoHS Compliant
- Halogen-free
- Naturally tacky

E-Fill 8400 Spec 08 is a performance-improved derivative of the original E-fill 8400 gap pad. It is exceptionally soft and exhibits good thermal performance. It is compliant to RoHS standard while maintaining its halogen-free status. These special features are benefited from the proprietary composition of metal oxide fillers in its binder matrix.

It is electrically non-conductive and naturally tacky. Additional adhesive is generally not required.



**Typical Applications**

- Cooling component to the chassis, frame, or other type of heat spreader
- Mass storage devise
- Heat pipe assemblies
- RDRAM memory modules
- Motor control
- Telecommunication hardware

**Optional Configurations**

- Can be die-cut into specific dimensions

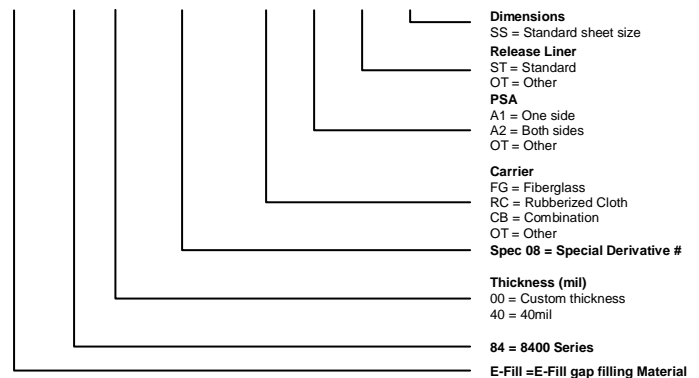
Properties	Typical Data	Test Method
Construction & Composition	Soft silicone elastomer	—
Color	Pink	Visual
Thickness Range /inch (mm)	0.01"~0.40" (0.254~10.16) in 0.01" (0.254) increments	—
Standard Sheet Size	12" x 16"	—
Density /g.cm <sup>3</sup>	2.56	—
Hardness /Shore 00	25	ASTM D2240
Tensile Strength /psi	20	ASTM D412
UL Flammability Rating	UL94 V0	—
Temperature Range /°C	-40~200°C	—
Thermal Conductivity W.m <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup>	2.5	ASTM D5470 (modified)
Breakdown Voltage /V	>5000 (Thickness ≤ 0.03") >6000 (Thickness = 0.04~0.05") >10000 (Thickness ≥ 0.06")	ASTM D149
Volume Resistivity /ohm.cm	7.5 x 10 <sup>13</sup>	ASTM D257
Dielectric Constant @ 1MHz	6.2	ASTM D150
Shelf Life	24 months	—

Please contact us for other special requirements

Carrier Treatment	Criteria
Fiber Glass (FG)	Compulsory for ≤ 0.03" (0.75mm)
Rubberized Cloth (RC)	Not Recommended
Pressure Sensitive Adhesive (PSA)	Not Recommended
Detachable Adhesive (DA)	Optional to ≥ 0.039" (1.0mm)
Aluminum Foil (AL)	Optional to ≥ 0.039" (1.0mm)
Kapton (PI)	Not Recommended
Talc treatment (DAT)	Optional to all thickness

**Product Code and Descriptions**

E-Fill 84 XX Spec 08 -XX -XX -XX -XX



**Hong Kong**

Tel: (852) 2686 8168  
Fax: (852) 2686 8268  
E-mail: emeihk@emeigroup.com

**Dongguan**

(86) 769-8334 1628  
(86) 769-8334 2028  
emeidg@emeigroup.com

**Shanghai**

(86) 21-5868 3381  
(86) 21-5868 3386  
emeish@emeigroup.com

**Taiwan**

(886) 2-2793 9055  
(886) 2-2793 9501  
emeitw@emeigroup.com

### 产品特点

- 导热率 2.5W/m-K
- 高压缩比
- 低成本
- 具有天然粘性
- 符合 RoHS 规格
- 无卤素

### 一般应用

- 底盘，框架或其他散热组件
- 热管组件
- 大容量存储设备
- RDRAM 记忆模组
- 电机控制器
- 通信用硬件

### 其他配置

- 产品厚度 ≤ 0.03"，建议使用玻璃纤维强化
- 可选择胶粘剂涂层
- 可选择导热绝缘布强化
- 可模切成特定尺寸

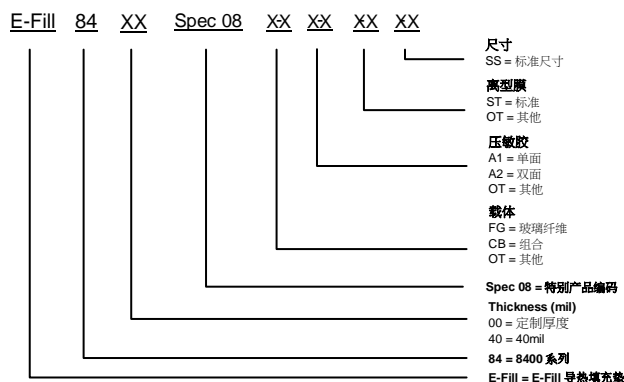
E-Fill 8400 Spec 08 是基于 E-Fill 8400 改良而成的。它是一种十分柔软而且拥有高导热效能的导热填充垫。独有的金属氧化填充物料及粘合剂配方不单指符合 RoHS 规格更达到无卤素要求，令客户在使用时对于有害物质的控制更有信心。

Fill 8400 Spec 08 具有电绝缘及天然粘性等特点，在正常情况下不需要增加额外的胶粘剂。

一般特性	一般数据	测试方法
结构及主要成分	硅树脂弹性体	—
颜色	粉红色	目测
厚度 /inch (mm)	0.01"~0.40" (0.254~10.16) 以 0.01" (0.254)为基本增量单位	—
标准片材尺寸	12" x 16"	—
密度 /g.cm <sup>-3</sup>	2.56	—
硬度 /Shore 00	25	ASTM D2240
拉伸强度 /psi	20	ASTM D412
UL 燃烧等级	UL94 V0	—
使用温度 /°C	-40~200°C	—
导热率 W.m <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup>	2.5	ASTM D5470 (modified)
击穿电压/V	>5000 (厚度 ≤ 0.03") >6000 (很多 = 0.04~0.05") >10000 (厚度 ≥ 0.06")	ASTM D149
体积电阻率 /ohm.cm	7.5 x 10 <sup>13</sup>	ASTM D257
介电常数@ 1MHz	6.2	ASTM D150
有效期	24 months	—
如对产品有特殊要求，请联络我们		

载体	标准
玻璃纤维 (FG)	厚度 ≤ 0.03" (0.75mm) 必须使用
胶布 (RC)	不建议使用
压敏胶 (PSA)	不建议使用
不粘胶 (DA)	可供厚度 ≥ 0.039" (1.0mm)使用
铝箔 (AL)	可供厚度 ≥ 0.039" (1.0mm)使用
聚酰亚胺膜 (PI)	不建议使用
滑石粉处理 (DAT)	可供任何厚度使用

### 产品编码及描述

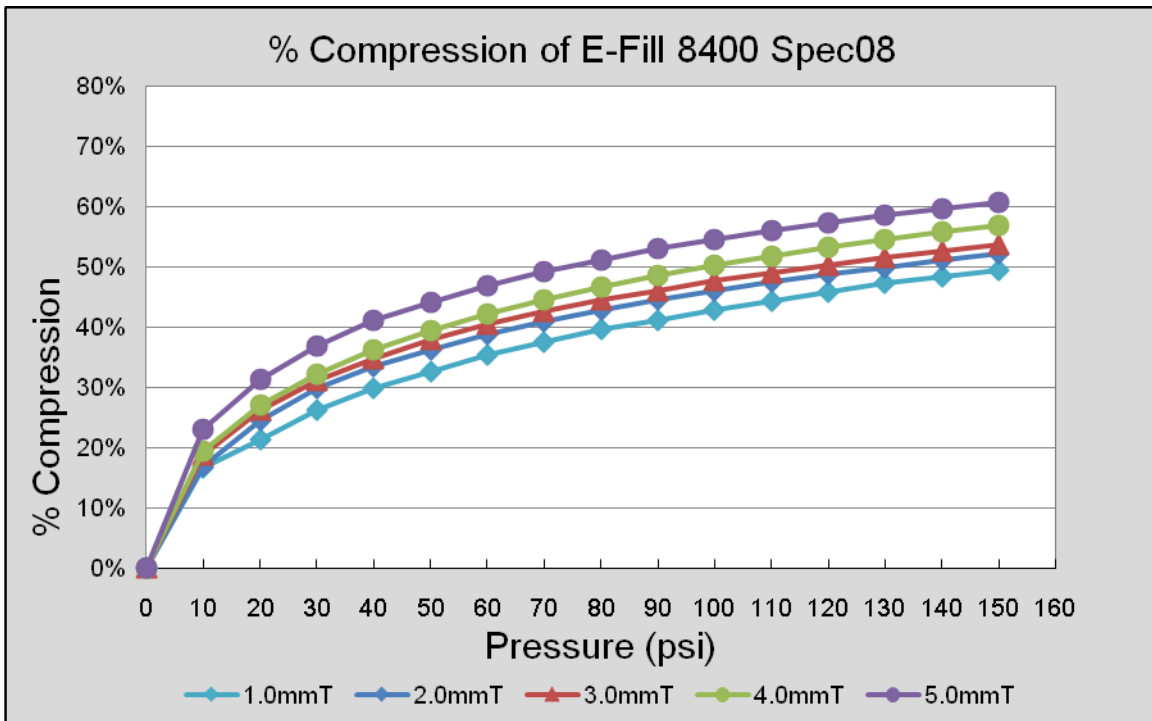
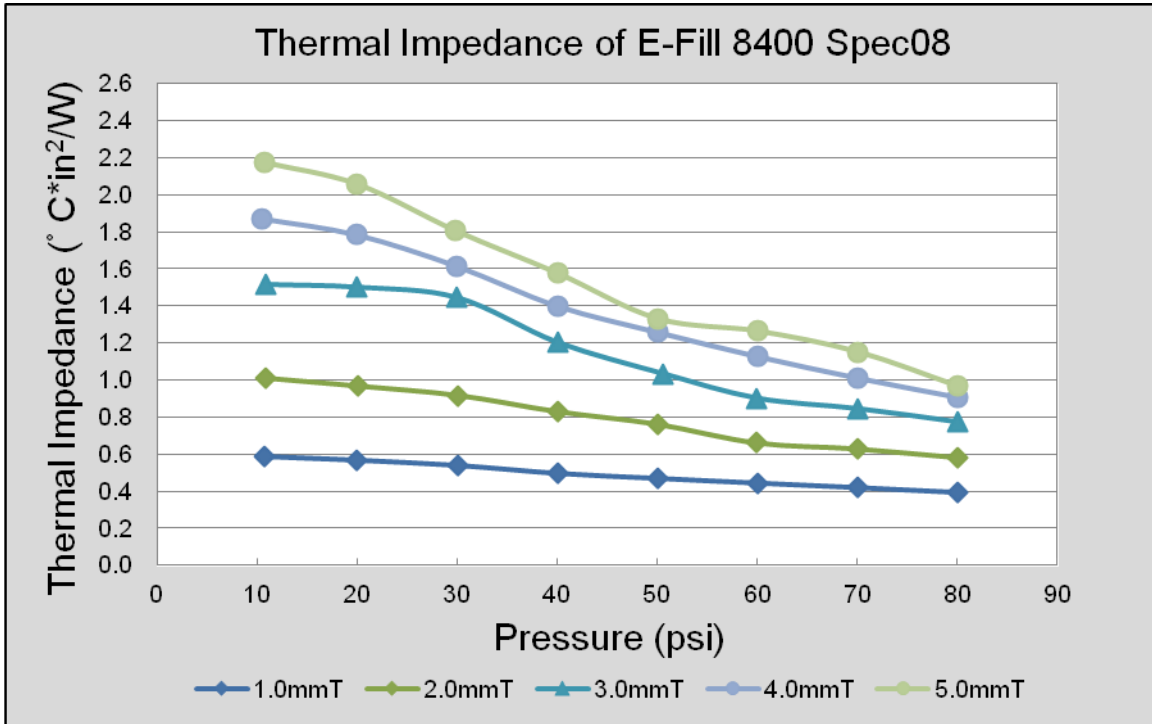


香港  
Tel: (852) 2686 8168  
Fax: (852) 2686 8268  
E-mail: emeihk@emeigroup.com

东莞  
(86) 769-8334 1628  
(86) 769-8334 2028  
emeidg@emeigroup.com

上海  
(86) 21-5868 3381  
(86) 21-5868 3386  
emeish@emeigroup.com

台湾  
(886) 2-2793 9055  
(886) 2-2793 9501  
emeitw@emeigroup.com



	<b>香港</b>	<b>东莞</b>	<b>上海</b>	<b>台湾</b>
Tel:	(852) 2686 8168	(86) 769-8334 1628	(86) 21-5868 3381	(886) 2-2793 9055
Fax:	(852) 2686 8268	(86) 769-8334 2028	(86) 21-5868 3386	(886) 2-2793 9501
E-mail:	emeihk@emeigroup.com	emeidg@emeigroup.com	emeish@emeigroup.com	emeitw@emeigroup.com